

AT&S

first choice for advanced applications

Unternehmenspräsentation

März 2016

AT&S & Vision & Mission

Vision

First choice for advanced applications

Mission

- Wir setzen die höchsten Qualitätsstandards in unserer Branche
- Wir industrialisieren zukunftsweisende Technologien
- Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt
- Wir reduzieren unseren ökologischen Fußabdruck
- Wir schaffen Werte

Agenda

AT&S auf einen Blick

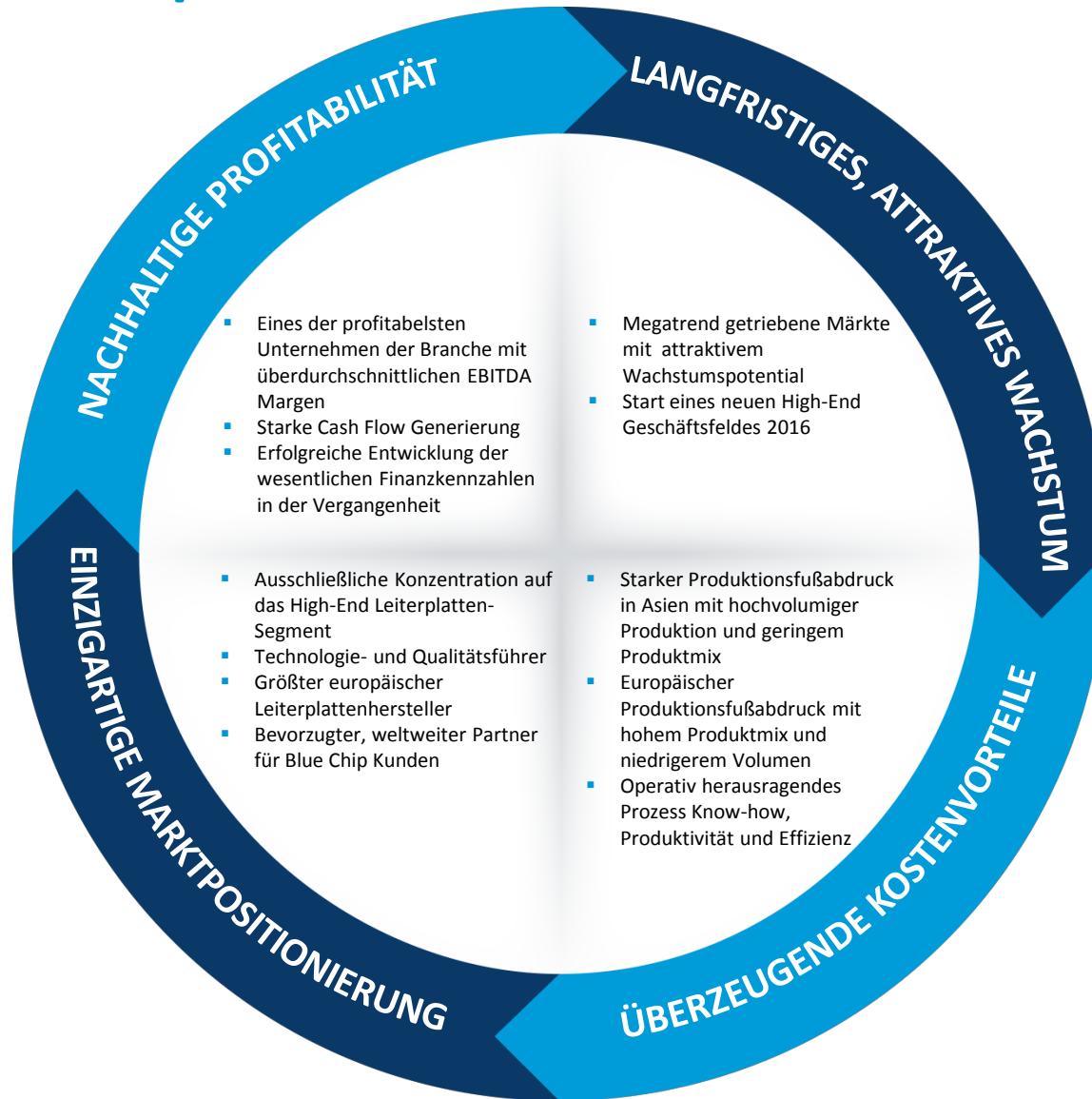
Trends in der Elektronikindustrie

AT&S Corporate Social Responsibility

AT&S Finanzdaten

Anhang

AT&S – ein weltweit führender High-Tech Leiterplatten-Hersteller

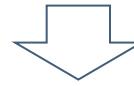


High-End Leiterplatten für High-End Anwendungen

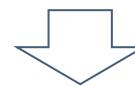
AT&S



Mobile Devices



Automotive



Industrial



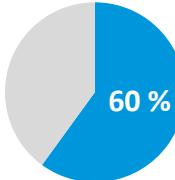
Medical

Smartphones, Tablets,
Ultrabooks, Wearables ..

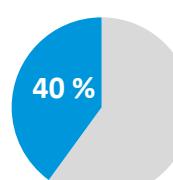
Navigation, Advanced
Driver Assistance
Systems, Infotainment..

Maschine-2-Maschine
Kommunikation,
Steuerung, Sensoren..

MRT, Hörgeräte,
Herzschrittmacher,
Online-Patienten-
monitoring



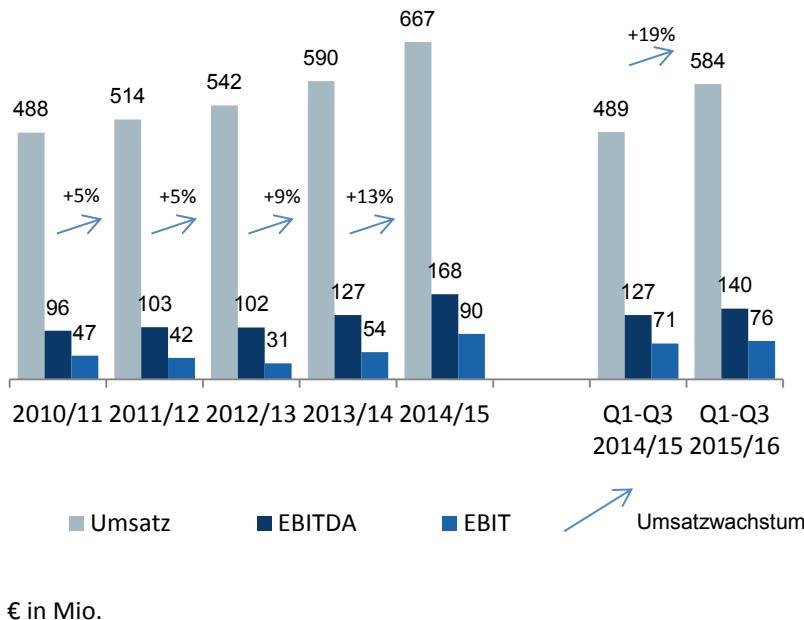
Umsatzanteil



Umsatzanteil

1

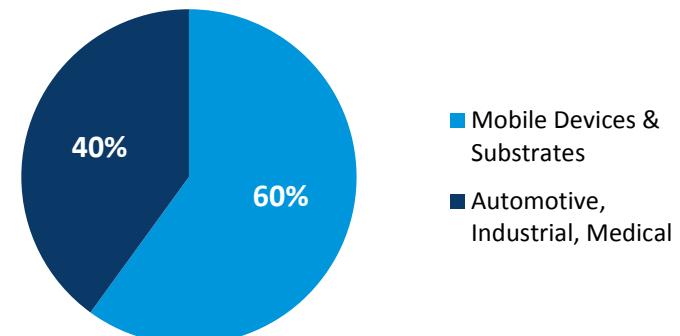
Starke Erfolgsbilanz



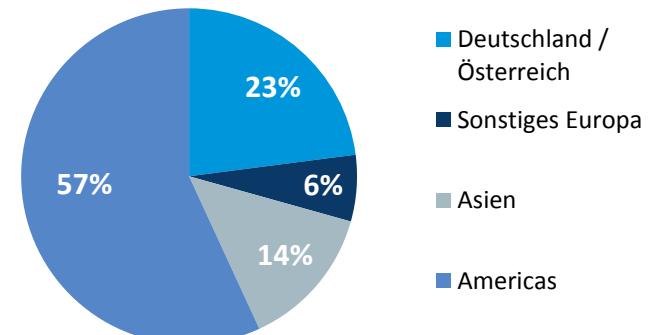
2

Diversifiziertes Portfolio / Globale Kunden

Umsatzverteilung nach Business Unit, Q1-Q3 2015/16



Umsatzverteilung nach Kundenregion, Q1-Q3 2015/16



Globale Präsenz

- Produktionsstandorte Europa: hohe Produktvielfalt/niedriges Volumen
- Produktionsstandorte Asien: hohes Volumen/niedrige Produktvielfalt
- Vertriebsnetzwerk umspannt drei Kontinente
- Rund 8.700 Mitarbeiter*



Leoben, Austria Headquarters

Mitarbeiter: ~ 1000



Fehring, Austria

Mitarbeiter: ~300



Nanjangud, India

Mitarbeiter: ~1.200



Chongqing, China in Bau

Mitarbeiter: ~1.300



Shanghai, China

Mitarbeiter: ~4.600



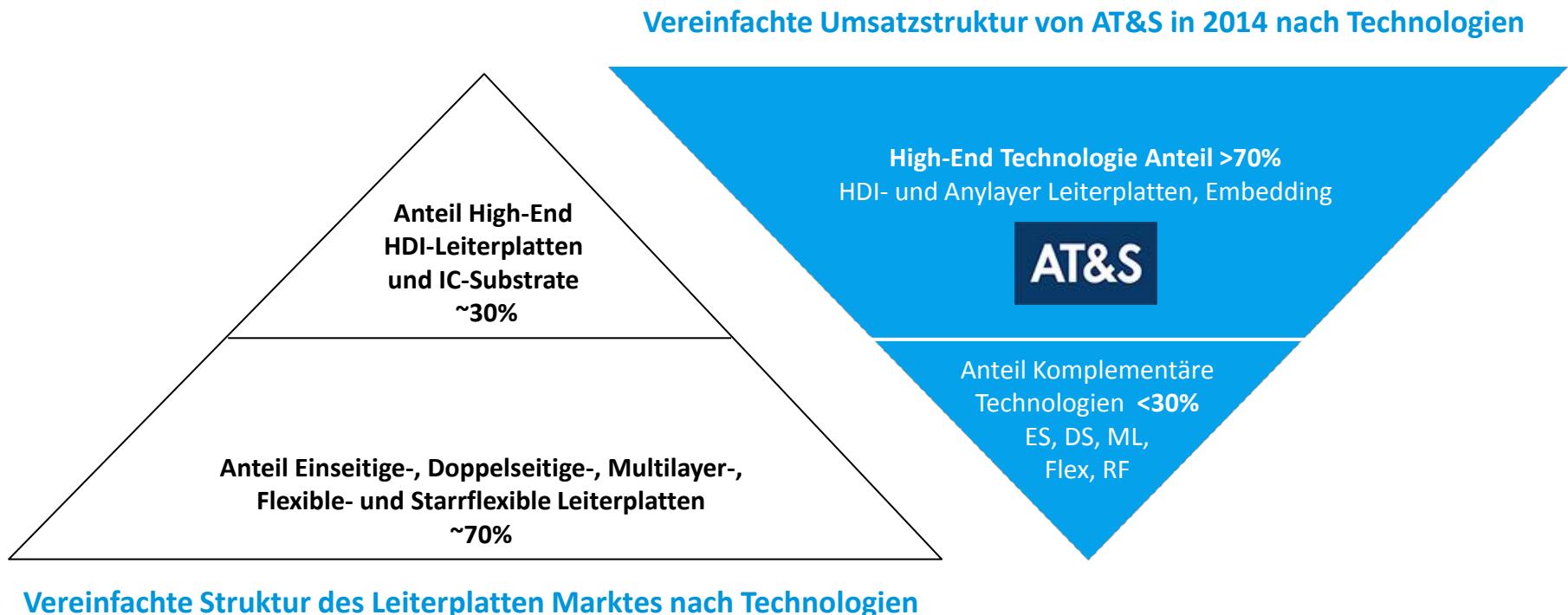
Ansan, Korea

Mitarbeiter: ~300



*Durchschnitt, FTE, H1 2015/16

Klarer Fokus auf High-End Technologien



Mitbewerber/HDI Technologie

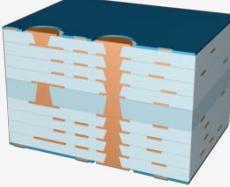
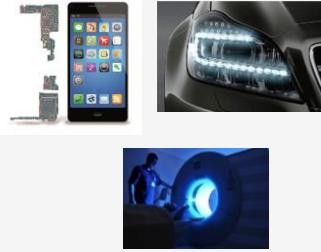
Marktposition HDI Technologie

Umsätze (USD in Mio.)						
Rang	Land	Produzenten	HDI	Andere Leiterplatten-technologie	IC-Substrate	Gesamtumsatz
1	TWN	Unimicron	682	671	795	2,148
2	TWN	Compeq	538	509	-	1,047
3	AUT	AT&S	530	248	-	778
4	KOR	SEMCO	480	173	1,212	1,865
5	JPN	Ibiden	426	-	1,080	1,506
6	USA	TTM	406	962	-	1,368
7	TWN	Zhen Ding	343	1,774	-	2,117
8	TWN	Tripod	305	1,077	-	1,382
9	KOR	DAP	279	21	-	300
10	TWN	Unitech	236	304	-	540

Quelle: Prismark, August 2014; NTI CY2013; AT&S Strategy

Technologiestrategie/-Portfolio ab 2016

AT&S

	Allgemeine Beschreibung und Technologie	Anwendungen	Kunden	Marktgröße*
Leiterplatten (HDI,...)	  <p>Leiterplatten sind die Verbindungsplattform für elektrische, elektronische und mechanische Komponenten (Widerstände, Kondensatoren, integrierte Schaltkreise, etc.) Dichte: Leiterbahn/Abstand > 25 Mikrometer</p>		<p>Computer, Consumer, Kommunikation, Automotive Industrial, Medical</p> <p>OEM's (Original-Hersteller) Tier 1 Tier 2</p>	<p>AT&S adressiert einen Markt von USD 5,8 Mrd.</p>
Substrat-ähnliche Leiterplatten	 <p>Substrat-ähnliche Leiterplatten sind die nächste Evolution von High-End HDI Leiterplatten mit einer größeren Dichte: Leiterbahn/Abstand: 20-30 Mikrometer</p>		<p>Wearables und andere Anwendungen für "Internet of Things"</p> <p>OEM's Tier 1 Tier 2</p>	<p>Technologie in Einführung, Teil des High-End HDI und Low-End Substrat Markts</p>

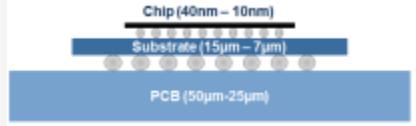
Warum AT&S in substrat-ähnliche Leiterplatten investiert:

- **Anhaltender Trend zu Miniaturisierung und zunehmender Modularisierung**
- **Frühzeitige Positionierung für die nächste Technologiegeneration**

* AT&S adressiert einen Teil eines Gesamtmarktes von USD 47 Mrd. / Quelle: Global Production Value 2014, Prismark, März 2015

Technologiestrategie/-Portfolio ab 2016

AT&S

	Allgemeine Beschreibung und Technologie	Application Areas	Customer Base	Market Size *
IC-Substrate	  <p>IC-Substrate dienen als Verbindungsplattform zwischen Leiterplatten und Halbleiter (Chips) mit einer höheren Dichte (Leiterbahn/Abstand < 15 Mikrometer)</p>		High-end Mikroprozessoren für Computer, Communication, Automotive, Industrial	OEM's, Halbleiter-industrie AT&S adressiert einen Markt von USD 5,1 Mrd.

Warum AT&S in IC-Substrate investiert:

- **Marktnachfrage: „Höherwertige Applikationen benötigen High-End Mikroprozessoren mit höherer Leistung“**
- **Technologie: „High-End Leiterplatten-Technologie“ und Substrat-Technologie für Halbleiter verschmelzen**

* AT&S adressiert einen Teil eines Gesamtmarktes von USD 7,6 Mrd. / Quelle: Global Production Value 2014, Prismark, März 2015

	Werk I	Werk II
Produkte:	IC Substrate	Substrat-ähnl. LP
Kapazität:	150.000 m ² /p.a.*	200.000 m ² /p.a.*

- Standort: Chongqing, Zentralchina
- Gesamtinvestment: € 480 Mio. in der 1. Phase
(bis Mitte 2017)
- Erwarteter Start:
 - > IC Substrate: Anfang 2016
 - > Substrat-ähnliche Leiterplatten: 2. Hälfte 2016

8

*bei Vollausbau



Übersicht Chongqing: IC-Substrate & substrat-ähnliche Leiterplatten

AT&S



Gebäude 1: IC Substrate Werk

Spezifikationen:

- Reinraum Klasse < 100

Gebäude 2: substrat-ähnliche Leiterplatten Werk

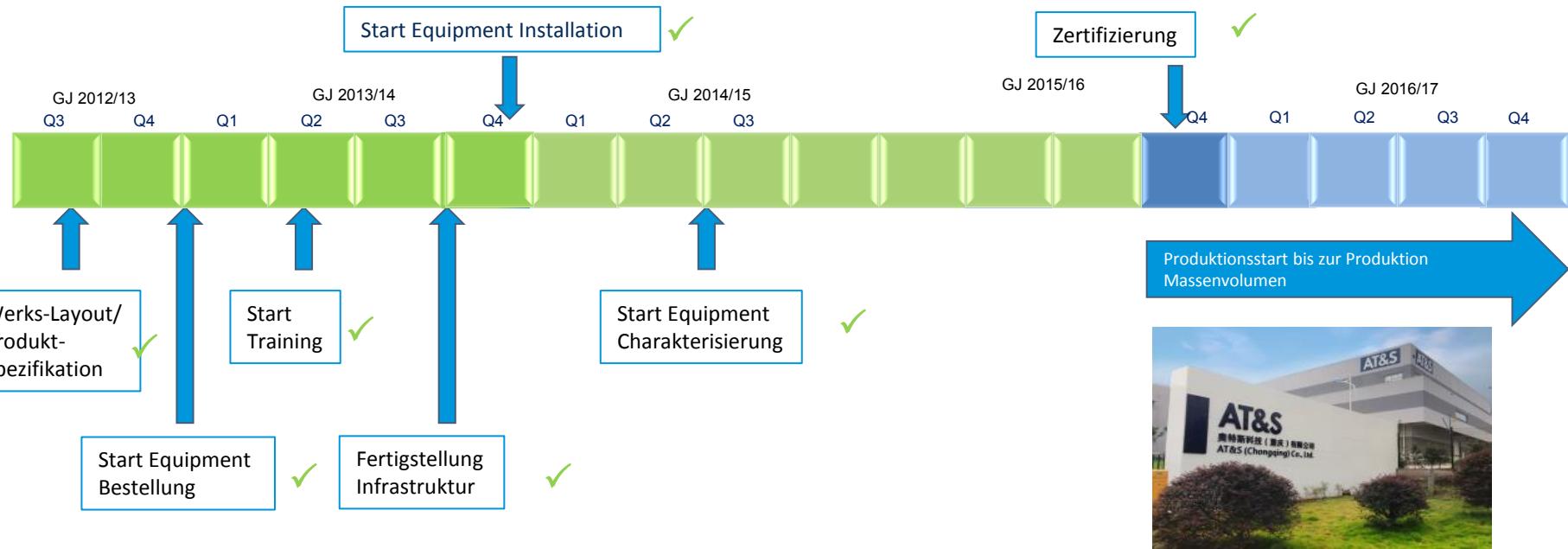
Spezifikationen:

- Reinraum Klasse < 10,000 bis < 1,000 in speziellen Bereichen

Projekt Status IC Substrate - Chongqing I

AT&S

(Stand 31.12.2015)



- Investment per 31.12.2015: € 195,6 Mio.¹⁾
- Zertifizierung im Februar erhalten, Produktionsstart für die erste Linie im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2015/16 (1. Jänner – 31. März)
- Produkte: IC-Substrate für Computing Anwendungen

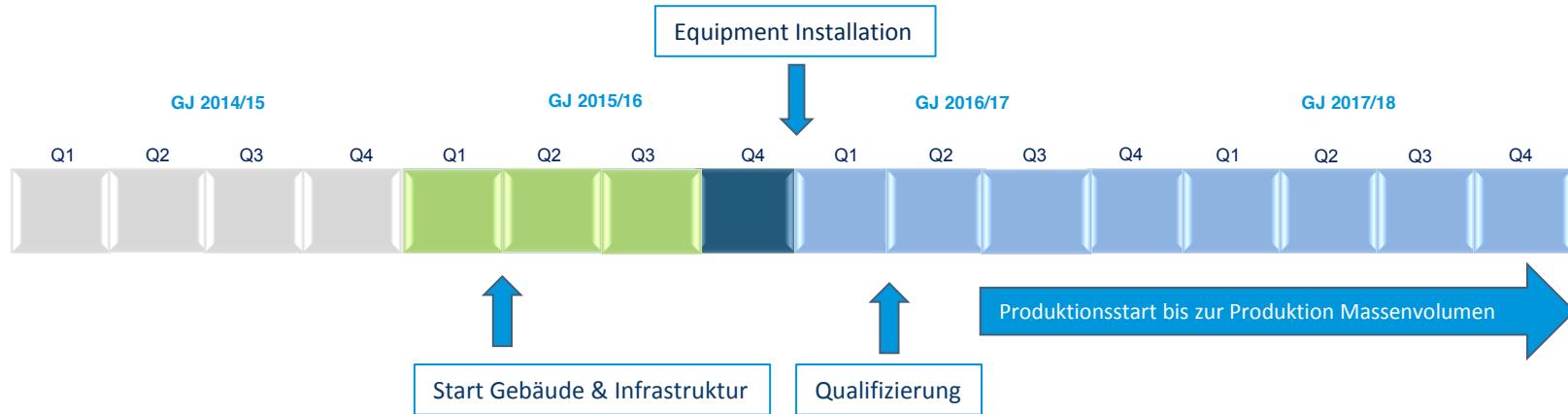


1) CAPEX in Sachanlagen

Substrat-ähnliche Leiterplatten – Chongqing II

AT&S

(Stand per 31.12.2015)



- Investment per 31.12.2015: € 45,3 Mio.¹⁾
- Erste Mengen werden bereits im Werk Shanghai produziert
- Aufbau Werksgebäude II für substrat-ähnliche Leiterplatten in Chongqing läuft
- Produktionsstart für zweite Hälfte 2016 erwartet

1) CAPEX in Sachanlagen

Agenda

AT&S auf einen Blick

Trends in der Elektronikindustrie

AT&S Corporate Social Responsibility

AT&S Finanzdaten

Anhang

Globale Trends, die unser Geschäft treiben

AT&S

Gesellschaft

Silver Society
Urbanisierung
Höhere Umweltstandards
Rohstoffknappheit
Wechsel der Denkweise
(Generation Z, ...)
Sich verändernde geografische
Märkte
Energieeffizienz
...

Globale Geschäftstrends

Recht am geistigen Eigentum
Weiter zunehmende Transparenz
(via internet)
Globalisierung (US, EU nach Asien)
Verbesserungen innerhalb der
Supply Chain (schnellere
Durchlaufzeiten)
Konzentration auf
Kernkompetenzen
Sichere Transaktionen
...

Elektronikindustrie

Wearables
Internet of Everything
Cloud Computing
Big Data
Mobilität (Smarter Verkehr, ...)
Maschine zu Maschine
Kommunikation
Auto zu X - Kommunikation
Medizin-Kommunikation
(Mensch-Maschine-
Schnittstelle,...)



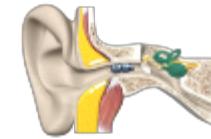
Wir können diese Trends nicht ändern, wir müssen für sie bereit sein!

Internet of Everything (IoE): AT&S fokussiert auf vier Anwendungsbereiche

AT&S

Wearable Electronics

- Healthcare



Smart Mobility

- Autonomes Fahren
- Car2Car Kommunikation



Smart City

- Smart Lighting



Smart Buildings

- Home/Gebäude-Automatisation
- Energiemanagement
- Automatisation/Robotics
- Produktions-Kontrollsysteme



Smart Production/Industry 4.0

- Konnektivität (z.B. Online Patientenüberwachung)



Smart Healthcare

- Intelligente Messgeräte



Smart Energy

- 30-50 Milliarden „Things“ werden 2020 miteinander vernetzt sein
- Der Markt für Wearables wird bis 2018 auf prognostizierte 10 – 60 Mrd. US\$ wachsen

Quelle: IHS, 2013

Trends in der Elektronikindustrie

Flexibilisierung, Miniaturisierung

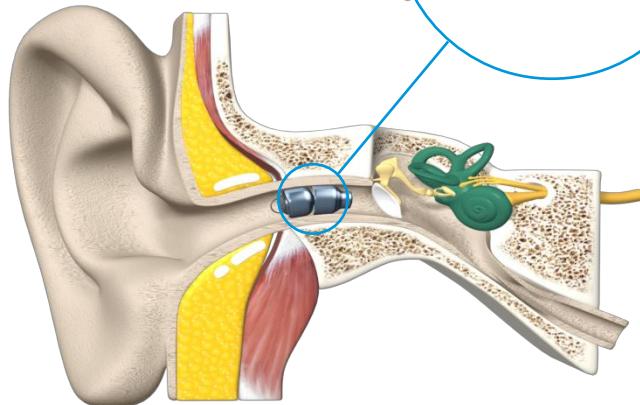
AT&S

Integration von Elektronik in unser tägliches Leben

Technologie trifft Design

Flexible Elektronik

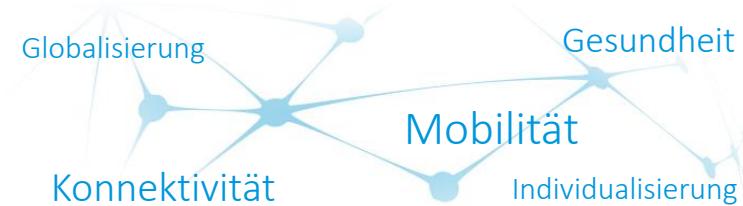
- Integration von Elektronik auf engstem Raum (Gehäuse, Auto, Medizintechnik)
- Tragbare Elektronik
- Verbindung von Elektronikmodulen



Fotoquelle: Shutterstock

Miniaturisierung

- Geräte werden immer kleiner, leichter und leistungsfähiger – Elektronik muss die Grundlage dafür schaffen



Trends in der Elektronikindustrie

Module / Packages

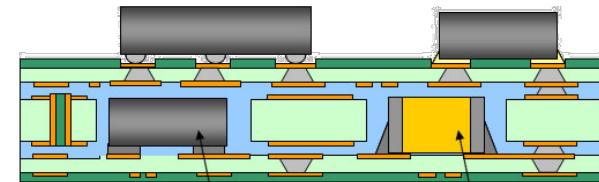
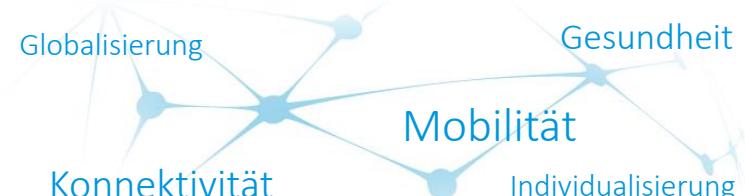
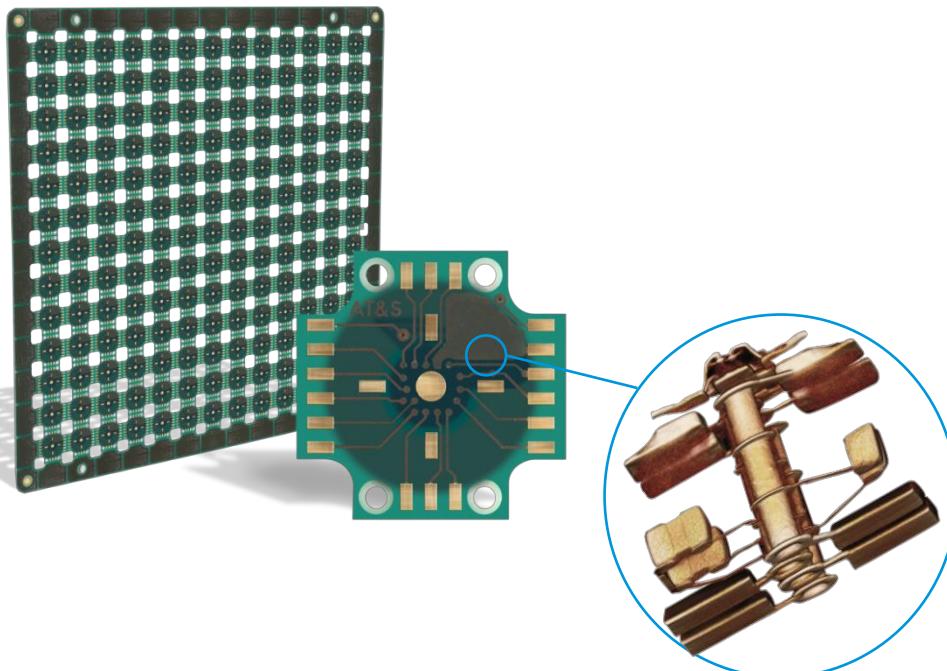
AT&S

Integration von Elektronik in unser tägliches Leben

Technologie trifft Design

Module / Packages

- Neue, höher integrierte Module zur Erreichung kleinste Packungsdichte und höchste Leistungsfähigkeit bei einer vereinfachten Wertschöpfungskette.



Anwendungen von Modulen:

- zentrale Prozessoreinheit
- Sensoreinheit
- Sendeeinheit
- Leistungsmanagement
- Kameramodule
- ...

3D
Röntgendarstellung
eingebetteter
elektronischer
Bauelemente



Trends in der Elektronikindustrie

Herstellungsprozesse / Geschäftsmodelle

AT&S

Herstellungsprozesse und Geschäftsmodelle sind in permanenter Veränderung

- Nutzung von Daten zur Optimierung und Verbesserung von Produktionsprozessen
- Integration neuer und zusätzlicher Schritte in die Wertschöpfungskette
- Automatisierung von Herstellungsprozessen und Abläufen des täglichen Lebens (z. B. Haushalt)
- Sparsamer Umgang mit Ressourcen in der Produktion

Smart Sensors kommunizieren untereinander und senden Auswertungen ihrer gesammelten Daten per Internet an zentrale Steuereinheiten.



Fotoquelle: Shutterstock



Agenda

AT&S auf einen Blick

Trends in der Elektronikindustrie

AT&S Corporate Social Responsibility

AT&S Finanzdaten

Anhang

immer wichtiger, um langfristig erfolgreich zu sein

- Effizienzsteigerung
- Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter



■ Stellenwert von Nachhaltigkeit steigt bei:

- Behörden
(Basis für Betriebsgenehmigung)
- Kunden
(wesentlich für Auftragsteilung)

Unsere Handlungsfelder



Energie und
CO₂ Fußabdruck



Wasser



Ressourcen



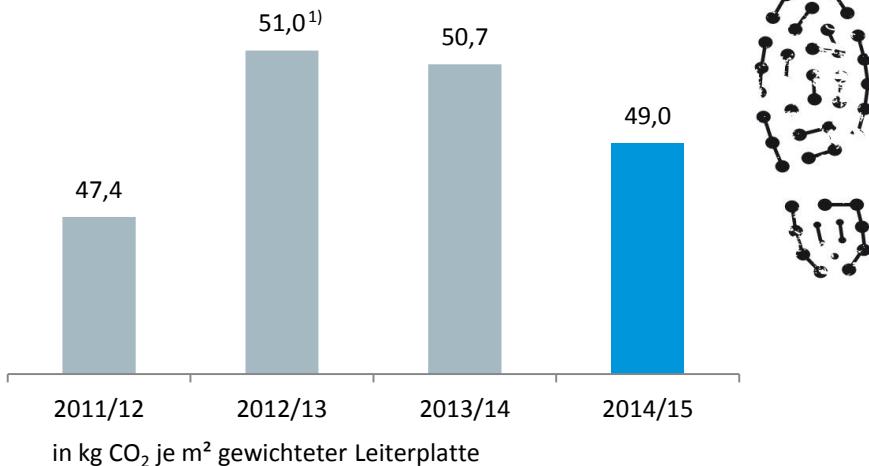
AT&S als Ort des Lernens



Zukunft gestalten
durch Vordenken

Nachhaltigkeit – Kennzahlen und Handlungsfelder

CO₂-Fußabdruck

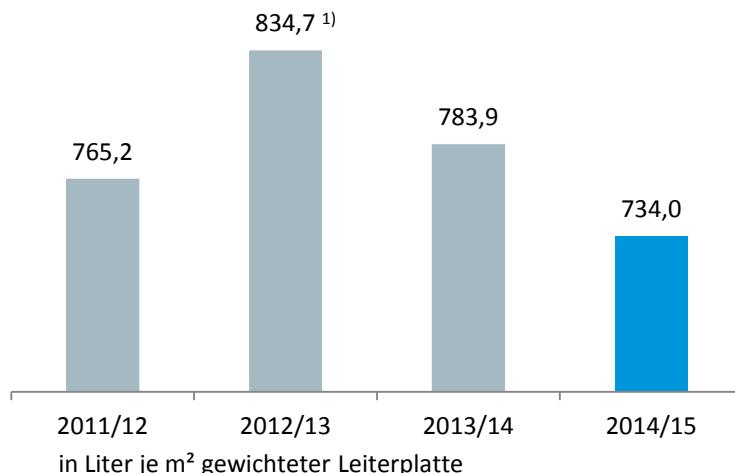


CO₂ Fußabdruck Ziel:
Reduktion der Emissionen je
kg/m² Leiterplatte um 5 %
jährlich

Ziel Frischwassereinsparung:
Reduktion des
Frischwasserverbrauchs in lt/m²
Leiterplatte um 3 % jährlich

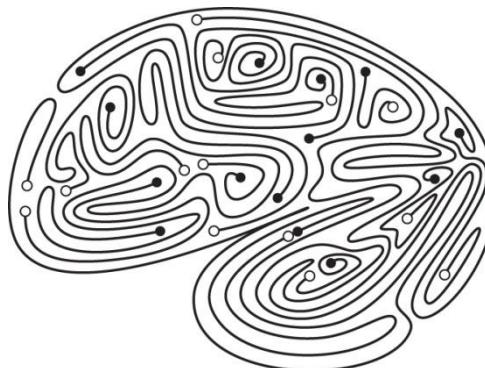


Frischwasserverbrauch



¹⁾ Ab 2012/13 Berechnung nach EICC-Standard, davor
AT&S interne Berechnung

Nachhaltigkeit – Handlungsfelder



Ressourcen

- Interner Benchmark von Recyclingaktivitäten
- Steigerung der Recyclingrate und Wiederverwertung von Abfällen
- Übergreifende Wertstromanalysen in ausgewählten Prozessen zur Effizienzsteigerung

AT&S als Ort des Lernens

- Aus- und Weiterbildungsprogramme für Mitarbeiter durch externe und interne Trainings
- Sicherung von Fachkräften
- Motivationsförderung durch Wissen

Zukunft gestalten durch Vordenken

- Kunden- bzw. Marktanforderungen
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Mitarbeiterbedürfnisse
- Einbindung der Lieferkette
- Business Ethik

Agenda

AT&S auf einen Blick

Trends in der Elektronikindustrie

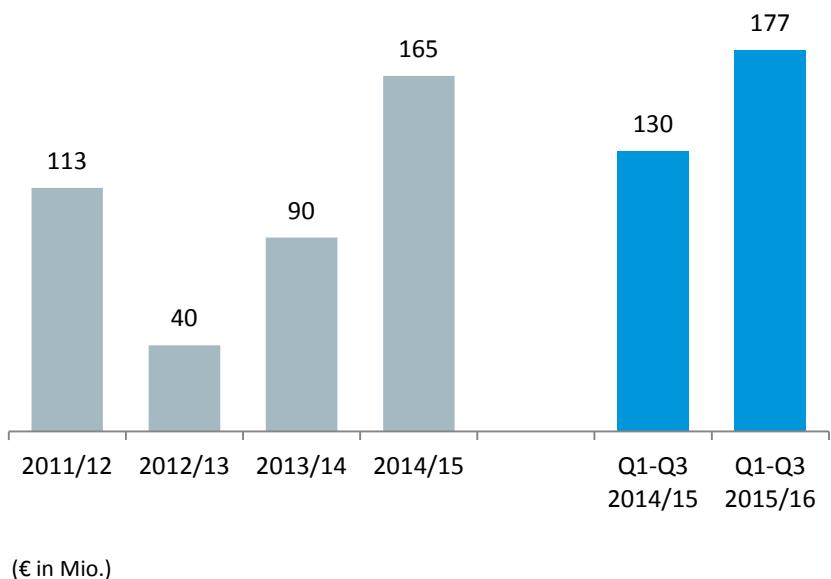
AT&S Corporate Social Responsibility

AT&S Finanzdaten

Anhang

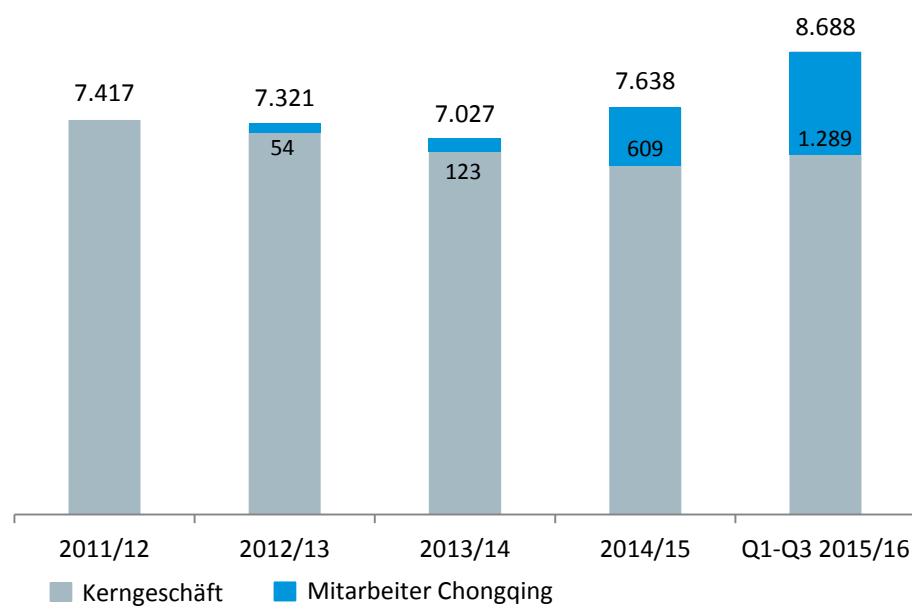
Netto-Investitionen

Das CAPEX beinhaltet Investitionen in das Projekt Chongqing (122,1 Mio. €) und Technologieupgrades in bestehende Standorte.



Mitarbeiter*

Der Mitarbeiterstand erhöhte sich insbesondere durch das Projekt Chongqing.

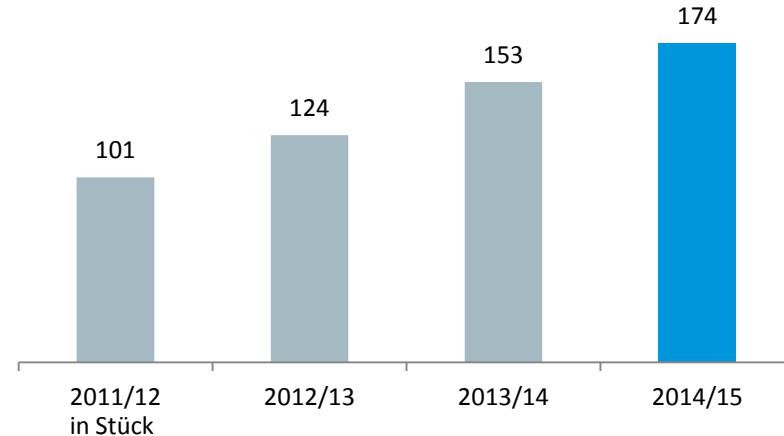


- Innovationskraft und langfristige Wettbewerbsfähigkeit zeigen sich auch in der Anzahl und Qualität der Patente.
- 29,2 % des Gesamtumsatzes der AT&S wird mit Produkten erzielt, welche neue, innovative Technologien aufweisen und die während der letzten drei Jahre auf dem Markt eingeführt wurden (Innovation Revenue Rate).
- Aktuell kommt AT&S auf 114 Patentfamilien, die in 174 Schutzrechten resultieren.
- Die Kosten für die Forschungs- und Entwicklungsprojekte beliefen sich im GJ 2014/15 auf 57,9 Mio. €. Dies entspricht einer Forschungsquote (d. h. Relation zum Umsatz) von 8,7 % gegenüber 5,4 % im Vorjahr.

IRR (Innovation Revenue Rate)



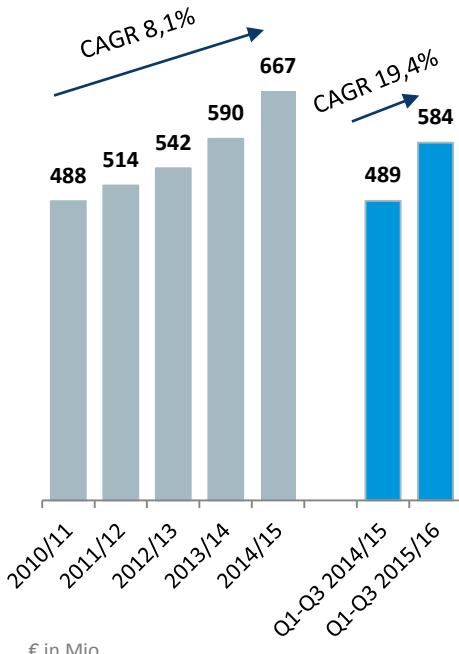
Schutzrechte der AT&S



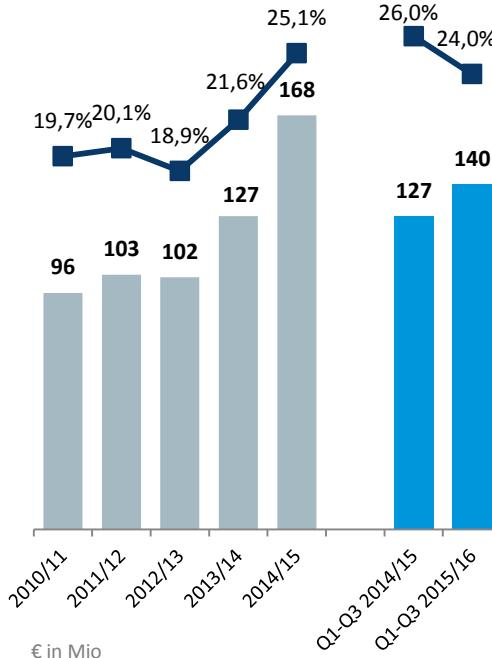
Solides Umsatzwachstum, überdurchschnittliche EBITDA-Margen und starker Cash Flow

AT&S

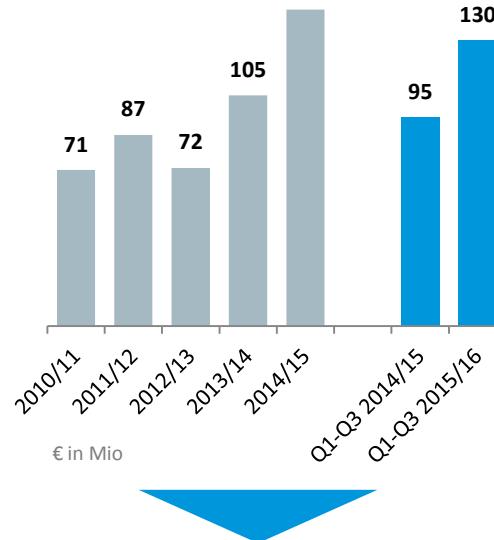
Umsatz



EBITDA und EBITDA-Marge



Operativer Cash-Flow



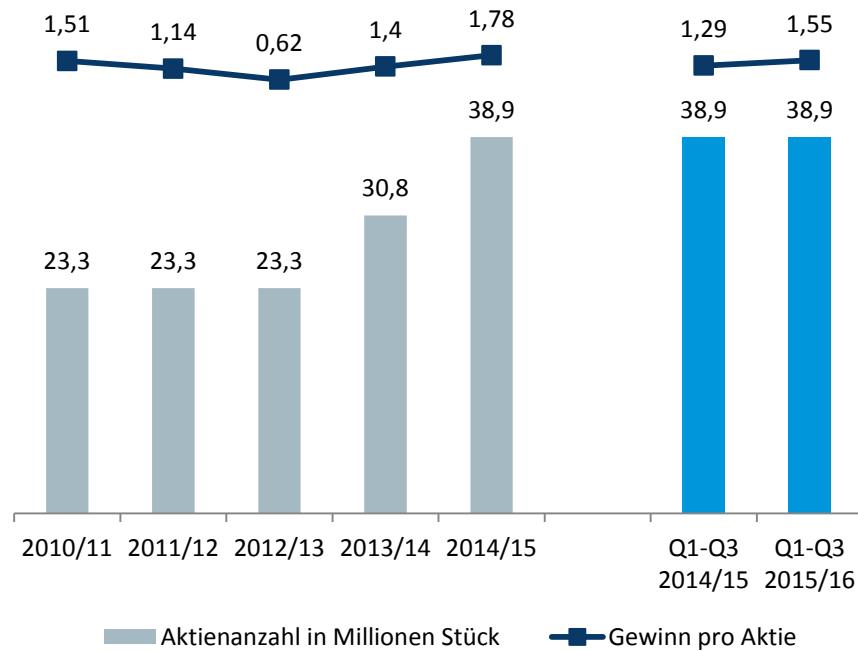
- Kontinuierliches Umsatzwachstum bis zur vollen Kapazitätsauslastung
- Umsätze in Asien produziert, erhöhten sich von 69 % 2010/11 auf 81 % in Q1-Q3 2015/16

- EBITDA Steigerung auf Basis der guten Auslastung
- EBITDA Margin Guidance GJ 2015/16: > 19 % auf Basis der Anlaufkosten für das im Aufbau befindliche Werk in Chongqing

- Operativer Cash Flow getrieben von der starken EBITDA Entwicklung

Konzernjahresergebnis und Gewinn pro Aktie

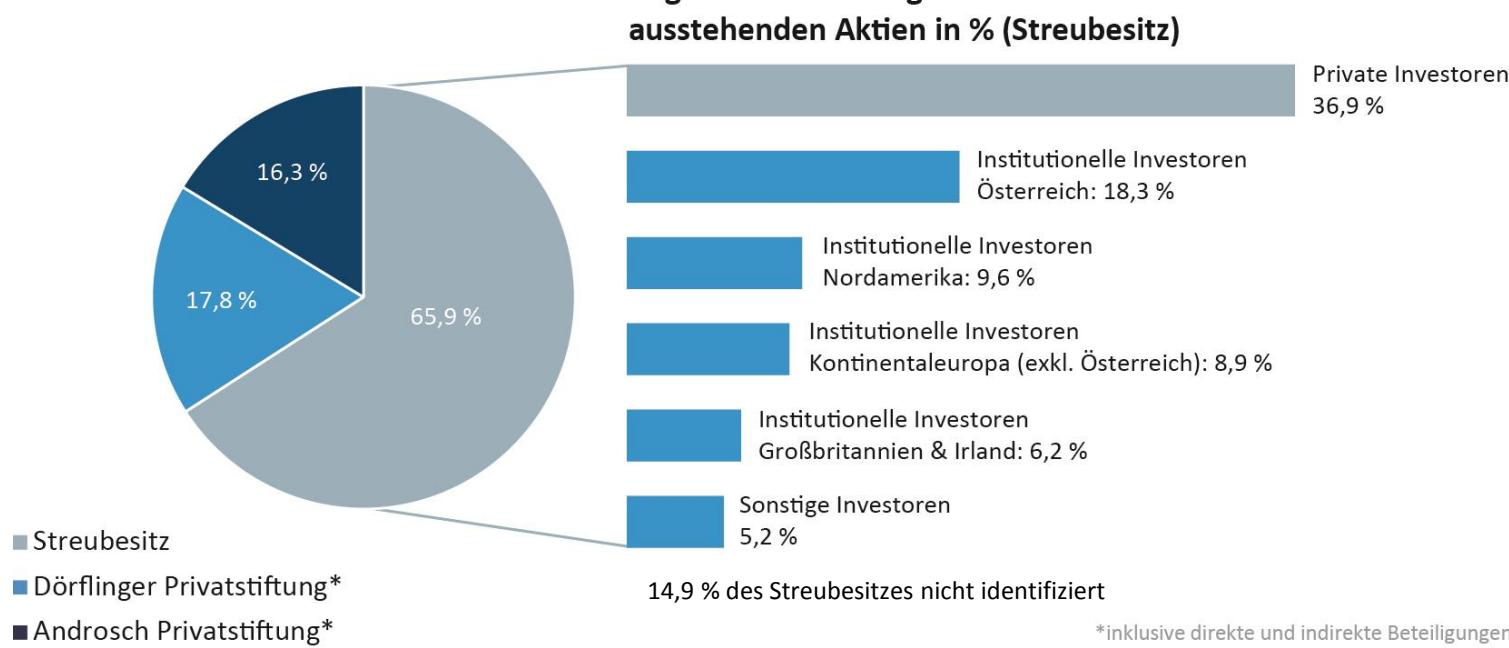
AT&S



- Gewinn pro Aktie erhöht sich um 19,6%

Börseplatz:	Wiener Börse, Prime Standard	Aktien im Umlauf	38.850.000
		Dividende 2014/15:	EUR 0,36/pro Aktie
Indizes:	ATX Prime, WBI	Dividendenrendite:	2,5%
ThomsonReuters (A):	ATSV.VI		
Bloomberg (A):	ATS AV		

Aktionärsstruktur



Agenda

AT&S auf einen Blick

Trends in der Elektronikindustrie

AT&S Corporate Social Responsibility

AT&S Finanzdaten

Anhang

Andreas Gerstenmayer, CEO



- Vorstandsvorsitzender (CEO) seit 2010
- Berufliche Erfahrung:
 - 18 Jahre im Siemens Konzern, Geschäftsführer Siemens Transportation Systems GmbH Austria und CEO der Business Unit Fahrwerke Graz (World Headquarters) von 2003 bis 2008
 - Gesellschafter der FOCUSON Business Consulting GmbH
- Ausbildung und andere Funktionen:
 - Vorsitzender des steirischen Forschungsrats
 - Abschluss als Diplomingenieur, Fachhochschule für Produktionstechnik Rosenheim, Deutschland

Karl M. Asamer, CFO



- Finanzvorstand (CFO) seit 2014
- Berufliche Erfahrung:
 - Geschäftsführender Gesellschafter GEKA Group Deutschland
 - Kaufmännischer Geschäftsführer Sell GmbH in Deutschland
- Ausbildung:
 - Abschluss als Doktor Betriebswissenschaft, J. Kepler Universität Linz, Österreich

Heinz Moitzi, COO



- Technikvorstand (COO) seit 2005; seit 1981 im Unternehmen (Vorläuferunternehmen der AT&S AG)
- Berufliche Erfahrung:
 - Verschiedene Managementpositionen bei AT&S
 - Messtechniker Montanuniversität Leoben
- Ausbildung:
 - Reifeprüfung HTBL für Elektrotechnik, Kapfenberg, Österreich
 - Elektroinstallationslehre Stadtwerke Judenburg, Österreich

1987

Unternehmensgründung,
hervorgegangen aus mehreren
Unternehmen im Eigentum
der Österreichischen
Verstaatlichten Industrie.

1994

Privatisierung und
Zuschlag an Androsch,
Dörflinger, Zoidl.

1999

Börsengang Frankfurt (Neuer Markt);
Akquisition von Indal Electronics Ltd.,
dem größten indischen Leiterplatten-
werk in Nanjangud, heute AT&S India
Private Limited.

2009

Neue Produktionsausrichtung:
Österreichische Werke produzieren
für hochwertige Nischen im Industrie-
und Automotive-Segment, Shanghai
konzentriert sich auf das High-End
Mobile Devices Segment.

2008

AT&S Wechsel an
die Wiener Börse

2006

Erwerb des koreanischen
Herstellers von flexiblen
Leiterplatten Tofic Co. Ltd.,
heute AT&S Korea Co., Ltd.

2002

Produktionsstart
im neuen Werk in
Shanghai – eines der
führenden HDI-Werke
der Welt.

2010

Produktionsstart
Werk II in Indien.

2011

- Spatenstich für neues Werk
in Chongqing, China
- Erhöhung der Kapazitäten
in Shanghai um 30 %.

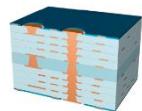
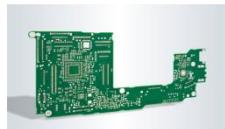
2013

AT&S steigt in Kooperation mit einem führenden
Halbleiterhersteller in das IC-Substrate-Geschäft ein.

2015

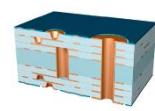
AT&S erzielt im Geschäftsjahr
2104/15 neuerlich Rekord-
werte bei Umsatz und Ertrag
und beschließt Erhöhung des
Investitionsprogramms in
Chongqing von 350 Mio. €
auf 480 Mio. €.

HDI Anylayer-Leiterplatte



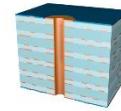
Technologische Weiterentwicklung der HDI Microvia: 100 % aller elektronischen Verbindungen werden über lasergebohrte Microvias realisiert. Vorteil: weitere Miniaturisierung bei höherer Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. AT&S stellt HDI Anylayer von 4 bis 12 Lagen her.

HDI Microvia-Leiterplatte



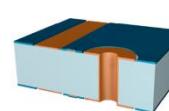
HDI: High Density Interconnection und steht für lasergebohrte Verbindungen (Microvias). HDI ist der erste Schritt zur Miniaturisierung. AT&S ermöglicht Varianten von 4 Lagen Laser bis zum 6-n-6 HDI Multilayer.

Multilayer-Leiterplatte



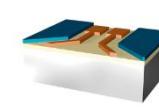
Findet man nahezu in jedem Bereich der Industrie-Elektronik. AT&S fertigt 4 bis 28-lagige Leiterplatten vom Einzelmuster bis zur Großserie.

Doppelseitige Leiterplatte



Werden in allen Bereichen der Elektronik eingesetzt. AT&S konzentriert sich auf doppelseitige Leiterplatten im Bereich von 0,1 mm bis 3,2 mm Dicke.

IMS Leiterplatte



IMS: Insulated Metal Substrate. Hauptfunktion: Wärmeableitung wird hauptsächlich für LEDs und sogenannten Leistungsbauteilen verwendet

Produktionsstandort

Shanghai

Shanghai, Leoben

Leoben, Nanjangud, Fehring

Fehring, Nanjangud

Fehring

Anwendungsbereiche

Smartphones, tablets, PCs

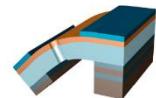
Mobiltelefone; in nahezu allen Elektronikbereichen, z.B. auch in Computer-Tomographen, Navigations-Infotainment- und Fahrerassistenzsystemen

Einsatz in allen Elektronikanwendungen, z.B. Touchpanels und vom Flugzeug bis zum Motorrad, vom Speicherkraftwerk bis zur Photovoltaik

Vorwiegend Industrie- und Automotive-Anwendungen

Lighting industry

Flexible Leiterplatte



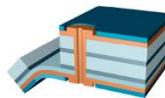
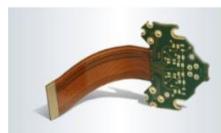
Ermöglicht den Ersatz von Kabeln und Steckern sowie Verbindungen und Geometrien, die mit starren Leiterplatten nicht möglich wären.

Semiflexible Leiterplatte



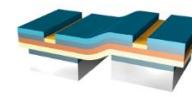
Im Vergleich zu flexiblen Leiterplatten begrenzte Biegeradien und -zyklen, Verwendung eines Standard-Dünnlaminats ermöglicht kostengünstige Alternativen.

Rigid-Flex-Leiterplatte



Bei Rigid-Flex-Leiterplatten werden die Vorteile der starren mit den Vorzügen der flexiblen Leiterplatte kombiniert. Dies bringt dem Anwender Vorteile in Bezug auf Signalübertragung, Größe und Stabilität.

Flexible Leiterplatte auf Aluminium



Um beispielsweise LED-Technologie im Frontscheinwerfer von Autos einsetzen zu können, werden flexible Leiterplatten mit einem Kühlkörper aus Aluminium verklebt und anschließend mit LED bestückt.

Produktionsstandort

Ansan, Fehring

Fehring

Leoben, Ansan

Ansan

Anwendungsbereiche

Nahezu alle Elektronikbereiche z. B. Messgeräte, Medizinanwendungen

Automotive-Anwendungen

Industrielektronik, z. B. Fertigungsmaschinen, Industrieroboter

Beleuchtung, Automotive, Gebäudebeleuchtung

Patentierte Technologien von AT&S

ECP: Embedded Component Packaging

ECP® ist eine von AT&S patentierte Packaging-Technologie zur Einbettung aktiver und passiver elektronischer Bauelemente in die Innenlagen der Leiterplatte. Die ECP®-Technologie findet Anwendung in immer kleineren, effizienteren und leistungsfähigeren Geräten wie beispielsweise Smartphones, Tablets, Digitalkameras und Hörgeräten.

Produktionsstandort: Leoben

2.5D® Technology Plattform

Kombiniert mechanische und elektrische Miniaturisierung und ermöglicht die partielle Reduktion der Stärke von Leiterplatten.

Vorteil: bestückte Baugruppen werden dünner.

Weiters können damit Hohlräume in die Leiterplatte gefertigt werden, um z. B. Akustikanäle zu realisieren. Ein Hauptanwendungsgebiet dieser Technologie ist die 2.5D®-Rigid-Flex-Leiterplatte, welche als kostenoptimierte Alternative für sogenannte Flex-to-install-Applikationen eingesetzt wird.

Produktionsstandorte:
Leoben, Shanghai

This presentation is provided by AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, having its headquarter at Fabriksgasse 13, 8700 Leoben, Austria ("AT&S"), and the contents are proprietary to AT&S and for information only.

AT&S does not provide any representations or warranties with regard to this presentation or for the correctness and completeness of the statements contained therein, and no reliance may be placed for any purpose whatsoever on the information contained in this presentation, which has not been independently verified. You are expressly cautioned not to place undue reliance on this information.

This presentation may contain forward-looking statements which were made on the basis of the information available at the time of preparation and on management's expectations and assumptions. However, such statements are by their very nature subject to known and unknown risks and uncertainties. As a result, actual developments, results, performance or events may vary significantly from the statements contained explicitly or implicitly herein.

Neither AT&S, nor any affiliated company, or any of their directors, officers, employees, advisors or agents accept any responsibility or liability (for negligence or otherwise) for any loss whatsoever out of the use of or otherwise in connection with this presentation. AT&S undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of changed assumptions or expectations, new information or future events.

This presentation does not constitute a recommendation, an offer or invitation, or solicitation of an offer, to subscribe for or purchase any securities, and neither this presentation nor anything contained herein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. This presentation does not constitute any financial analysis or financial research and may not be construed to be or form part of a prospectus. This presentation is not directed at, or intended for distribution to or use by, any person or entity that is a citizen or resident or located in any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to law or regulation or which would require any registration or licensing within such jurisdiction.